

Serveurs

## LENOVO THINKSERVER TD230

Détails de la notation :

C-	NOTE RSE	>
D-	NOTE CYCLE DE VIE	>
E-	NOTE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE	>

Code EAN :

[VOIR LA FICHE CONSTRUCTEUR >](#)

[DÉCOUVRIR NOTRE MÉTHODOLOGIE >](#)

Gamme de prix

**1000 – 2000 €**



Le serveur **ThinkServer TD230** de **LENOVO** au format **Tour** propose une capacité de stockage de **2000 Go**.

Il est labellisé **Energy Star**.



ENERGY STAR

## MATURITÉ RSE



C-

LENOVO publie un rapport RSE synthétique dans lequel les points clefs ESG sont abordés. LENOVO a récemment obtenu la certification ISO 5001 et poursuit des objectifs de réduction de consommation énergétique tout en rapportant les solutions mises en place et les performances réalisées. L'entreprise a pour objectif d'atteindre une totalité de fournisseurs n'utilisant pas de minerais de conflit. LENOVO concentre son programme d'inclusion des diversités sur l'accession aux postes clefs par des femmes et son aide aux communautés locales se focalise majoritairement sur l'éducation. Néanmoins, aucune politique claire n'a été prise concernant la consommation d'eau, et cette dernière apparaît en constante augmentation. Les objectifs environnementaux fixés par LENOVO concernent majoritairement l'Union Européenne et non pas la globalité des sites. Enfin, la politique d'inclusion des diversités reste sommaire et l'accessibilité aux produits ou le développement de produits destinés aux personnes handicapées n'est pas communiqué.

## CYCLE DE VIE



D-

**3 ans**

De garantie

**5 ans**

De disponibilité des pièces

#### LES PLUS

- Possibilité d'extension ou d'échange de la mémoire
- Possibilité d'extension ou d'échange de la capacité de stockage
- Est garanti 3 années
- Pièces de rechange disponibles durant 5 années

#### LES MOINS

- Ne communique aucune information sur le respect de REACH

#### EXTRACTION DES MATIÈRES PREMIÈRES

Masse de la RAM (Go)	<b>2</b>
Masse de la Mémoire Flash (Go)	<b>Non-communicé</b>
Masse de la carte mère	<b>Non-communicé</b>
Masse du microprocesseur + masse de la carte graphique ou la surface de silicium dans le microprocesseur la carte graphique	<b>Non-communicé</b>

#### FABRICATION

Utilisation de CFCs, HCFCs, 1.1.1 trichloro-ethane ou carbon-tetrachloride pour la production du produit final ou des modules le composant au sein du produit	<b>Non-communicé</b>
---	----------------------

#### DISTRIBUTION

Monomatière dans l'emballage	<b>Non-communicé</b>
Emballage sans PVC	<b>Non-communicé</b>

#### UTILISATION

Emission de COV (mg/h)	<b>Non-communicé</b>
Limitation des champs électromagnétiques créés par le produit	<b>Non-communicé</b>

#### DURÉE DE VIE EN PARC

Durée de garantie (année)	<b>3</b>
Disponibilité des pièces dans le temps (année)	<b>5</b>

## FIN DE VIE

Exclu des substances au-delà des exigences réglementaires	<b>Non-communicé</b>
Identification des plastiques	<b>Non-communicé</b>
Contient des substances REACH	<b>Oui</b>
Contient du PVC dans les parties extérieures du produit	<b>Non-communicé</b>
Contient des Retardateurs de Flamme Halogénés dans les plastiques	<b>Non-communicé</b>
Contient du mercure dans les sources de lumières dans l'électronique	<b>Non-communicé</b>
Contient des Retardateurs de Flamme Halogénés dans les circuits imprimés et dans l'électronique	<b>Non-communicé</b>
Contient du PVC dans l'électronique	<b>Non-communicé</b>
Présence de revêtement de surface pour les parties plastiques du boîtier/capots	<b>Non-communicé</b>
Communication du pourcentage de recyclabilité, selon le calcul IEC/TR 62635:2012	<b>Non</b>
Extension ou échange de la mémoire possible	<b>Oui</b>
Possibilité d'échange ou d'extension de la capacité de stockage	<b>Oui</b>
Parties et étiquettes facilement séparables	<b>Non-communicé</b>
Pièces plastiques monomatériaux ou facilement séparables	<b>Non-communicé</b>
Pièces plastiques sans incrustation métallique ou faciles à extraire avec les outils couramment disponibles	<b>Non-communicé</b>

## CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE



E-

---

Dispositif d'économie d'énergie

**Non**

---

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



---

Taille du rack (U)

**Tour**

---

Type de disque dur

**SATA**

---

Taille du disque dur

**2000**

---

Type de RAM

**DDR3**

---

Type de processeur

**Intel Xeon séries 5500 et 5600**

---

Cadence du processeur (GHz)

**2**

---

Carte DRAC

**Non-communicé**

---

Carte contrôleur

**Non-communicé**

---

Carte Réseau

**Non-communicé**

---

Dissipation calorifique (kj/h)

**Non-communicé**

---

Dimensions HxLxP (mm)

**Non-communicé**

---